

# 贵州振华风光半导体股份有限公司

## 2025 年“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告

### 暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“振华风光”）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，秉承中国电子“打造国家网信事业战略科技力量”、中国振华“打造电子元器件产业生态链”的定位，认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，深入践行以“投资者为本”的理念，持续提升公司经营质量，增强投资者回报、提升投资者获得感。

现将 2025 年度的主要工作成果进行报告，并明确 2026 年度行动方案。具体内容如下：

#### 第一部分 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告

2025 年，公司紧扣“十四五”规划收官，谋篇“十五五”发展规划，聚焦主责主业，在挑战中坚守，聚焦提质增效，在困境中实现关键突破。

##### 一、聚焦经营主业，提升核心竞争力

###### （一）加强研发投入

2025 年度，公司研发投入约 1.72 亿元，占营业收入比例为 22.25%，较上年同期增加 7.94 个百分点。截至 2025 年 12 月 31 日，公司研发人员数量增加至 264 人，占公司总人数的比例为 30.88%，较上年同期增加 1 个百分点。公司获得新增授权发明专利 18 项，累计获取发明专利 64 项。

2025 年度，连续成功推出 100 余款性能更优、适配性更强的新产品，各产品线 and 谱系不断拓展升级。其中涵盖高性能可编程放大器、高速低失真放大器等为代表的放大器产品门类；栅极驱动器、磁编码器等为代表的专用转换器门类；智能栅极

驱动器等为代表的接口驱动；全系列信号调理系统、电机控制系统、射频收发硬件平台等为代表的系统集成封装电路门类；高精度低温漂基准、低压线性稳压器、高功率脉宽调制器等为代表的电源管理器门类；18GHz 微波频率合成器、超宽带捷变频射频收发芯片等为代表的射频微波门类；超低功耗 MCU——HYS1000 系列为代表的 MCU 门类；辐照级 R/D 转换器、高功率运算放大器等为代表的抗辐照产品门类。

## （二）夯实技术实力

2025 年，在集成电路设计领域公司共申请了相关发明专利 48 项，发表学术论文 6 篇。在集成电路封测领域，申请发明专利 13 件。在产品研发方面，突破了摆率提升、低失真、极点编程、温度数字补偿与传感器信号采集技术等多项核心技术；在封装方面，开发了裸芯片减薄、多层叠片封装、转角折叠金丝键合、裸芯片矩阵式植球等多项工艺技术；在产品测试方面，突破了高阶激光修调技术和“半光斑”修调技术、FIB（聚焦离子束）切割开窗等多项关键技术。通过开展新产品的自主研发和关键技术攻关，新增 IC 设计、封装、测试等多项关键技术，持续巩固并提升产品竞争优势。

## （三）完善布局产业链条

2025 年，针对再布线（RDL）、晶圆凸点（Bumping）产品的市场前景、技术托底、产业现状以及产品潜在客户与目标客户需求转换等情况进行了梳理和论证，完成了 TSV、晶圆级封装、扇出型面板级封装等技术路线梳理，并同步推进市场分析、设备调研及厂房改造方案论证，形成系统性的 WLP 封装及 2.5/3D 封装需求的模拟/数模集成电路、数字电路产品谱系图，同时完成研发中心建设项目的结项工作，通过项目建设，公司成功构建了国内领先模拟集成电路协同设计与仿真验证平台。

公司与国内复旦大学、哈尔滨工业大学、西安电子科技大学等顶尖高校，与成都、广州、上海、苏州、重庆、深圳、哈尔滨等地的多家半导体顶尖企业和科研院所聚焦行业前沿核心技术突破，弥补关键技术短板，开展汽车电子、电力工业、商业航天等民用领域的技术研究、协同创新等合作，实现优势互补、资源共享的集成电路产业生态链，构建“产学研用”深度融合的协同生态，共同推动集成电路产业的

繁荣发展。

## 二、深化改革赋能 精益提质增效

### （一）聚焦科技创新和市场化改革

振华风光将持续探索改革路径，聚焦制约高质量发展的突出矛盾与问题，围绕“提高核心竞争力、增强核心功能”，明确改革思路与目标，聚焦科技创新和市场化改革，将改革责任层层落实到位，深入推进改革工作走深走实。

#### 1. 在科技创新方面

一是持续执行项目经理人机制，放宽科研项目管理授权范围，充分赋予科研项目负责人团队组建权、技术路线决定权、考核分配权和经费使用权，激活研发组织活力，2025年，持续推动技术创新和产品升级，推出100余款新品，产品线和谱系不断拓展升级，为市场拓展提供了有力支撑。

#### 2. 在市场化人员管理方面

一是根据公司年度经营目标，与经理层成员签订年度经营业绩责任书和经营业绩合同书，全面落实经理层任期内的“契约化”管理。

二是将“任期制”和“契约化”管理体制扩面，进一步延伸到中层管理干部，以年度考核为干部抓手，落实干部能上能下的选人用人机制，打造高素质专业化干部队伍。

三是着手“劳动、用人、分配”三项基本制度改革，修订了2025年薪酬与绩效考核方案，建立以公司整体绩效为牵引、以岗位价值创造为导向的绩效评价体系。

四是强化员工能力与岗位要求匹配程度，通过加大考核力度，优化人才结构、差异化激励等多措并举，提升引才空间，全年引进2名博士，23名硕士。

#### 3. 在市场改革方面

2025年，公司持续深化“客户-方案-交付”的三角营销模式，整合FAE/AE团队聚焦新品推广与新市场开发，推动市场与技术深度协同，为用户提供系统整体解决方案，成功挖掘70余项新品研发立项需求，实现市场需求与研发创新高效对接、

同频共振，为巩固市场优势、拓展大市场空间提供了坚实支撑。

## **（二）力稳品质，降本提效**

2025年，公司紧紧围绕“力稳品质、降本提效”核心目标精准施策、靶向发力。研发端深化产品谱系化开发与项目进度管控，持续压降研发投入成本；采购端加快新供方引入与商务谈判议价，采购周期明显缩短、成本有效控制；生产端聚焦工艺优化升级，推动产品良品率与生产效率同步提升；库存管理依托精准产销协同预测，合理压缩存货规模。通过多维度统筹施策，资源配置持续优化，经营成本有效管控，为全年经营目标圆满达成提供了坚实保障资金周转效率持续提升，其他方面，严格控制费用支出，积极争取各项政策优惠。

## **（三）质量攻坚，品质跃升**

体系建设持续强化，完成多项体系审核与认证（含 IATF16949、AS9100D 等）及相关承制审查，获评制造企业质量管理能力“保证级”。通过建立中测手段、优化工序工艺、加强环境管控、升级自动化检测设备、开展专项攻关等措施，产品综合合格率有所提升，质量损失率从有所下降。全年全员主动识别质量风险，促进关键工序质量稳定性及产品质量可靠性提升；依托质量信息化平台，完善技术要求、优化流程、完善管理要求，质量水平得到进一步提升。

## **三、持续完善公司治理，推动公司高质量发展**

2025年公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则，结合公司经营发展需求及实际情况，完成《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》《审计委员会议事规则》《董事离职管理制度》等共计 30 余项管理制度的修订及新增工作。

### **（一）深化治理架构改革，构建协同高效现代治理格局**

在治理机制上，公司严格按照法律法规及监管要求，平稳完成监事会建制撤销工作，由董事会审计委员会全面承接监督职能，通过监督资源整合、流程再造与机

制闭环，进一步理顺决策、执行、监督各环节关系，形成权责统一、监督到位、协同高效的新型治理运行体系。在组织赋能上，聚焦数字化转型与内控提质增效，优化调整职能机构设置，整合组建流程与 IT 部，推动内控管理、信息化建设、网络安全、流程优化等职能深度融合，以“流程+IT”双轮驱动打通数据壁垒、强化执行刚性，全面提升公司数字化治理能力与现代化管理水平。

## （二）健全制度规则体系，夯实规范治理长效根基

公司全面厘清治理主体权责，将“三重一大”决策要求深度嵌入治理流程，制定发布《各治理主体权责清单》，同步更新《内部控制管理权限表》，清晰界定党委、董事会、经理层权责边界，确保党的领导全面融入公司治理各环节。系统构建制度框架，制定《振华风光规章制度框架指引》，推动各管理领域制度协同衔接、上下贯通，提升制度执行力与穿透性。严格规范制度全生命周期管理，出台《规章制度管理规则》，建立分层分级、标准统一的制度管控机制，为公司规范运营、科学决策提供坚实制度支撑。

## 四、夯实 ESG 管理水平，深化投资者关系建设

报告期内，国内权威 ESG 评级机构 Wind、华证发布 2025 年度最新评价结果，振华风光双双获评 A 级，充分彰显公司优异的综合治理能力与可持续发展综合实力。长期以来，公司深度践行绿色可持续发展理念，持续完善 ESG 指标体系搭建，规范优化 ESG 数据收集、核算、全流程管理，不断提升披露数据的准确性、可靠性与横向可比性，全面夯实企业 ESG 精细化管理水平。

发展过程中，公司坚守绿色发展底线，将环境责任作为可持续发展核心生命线，以环境合规为战略发展锚点，聚焦能源资源高效利用、污染综合治理等关键工作，坚持统筹管控、科技赋能的发展路径，稳步推动经营效益与生态环境效益协同共进。

与此同时，公司高度重视投资者关系管理，牢固树立“以投资者为中心”的核心理念，持续健全多渠道沟通机制，全方位做好公司价值传递。依托 IR 热线、IR 专属邮箱、上交所 E 互动平台、官方网站、投资者交流会等多元化交流载体，搭建

公开透明、规范高效的沟通桥梁，及时精准披露经营信息、认真倾听投资者诉求与建议。2025 年度，公司累计接听投资者热线 100 余次，E 互动平台回复 183 条，热线及线上问答回复率达 100%；全年参与集体交流活动、行业策略会多场，举办业绩说明会 3 场，接待机构专项调研 40 余场，以高质量、常态化的投关服务，持续维护稳定良好的资本市场形象，切实保障投资者合法权益。

## **五、注重投资者回报机制，共享公司发展红利**

### **（一）制定股东分红回报规划，提升投资者获得感**

公司坚持稳健、可持续的分红策略，兼顾现金分红的连续性和稳定性，根据公司的盈利情况、现金流状况以及未来发展规划等因素，制定合理的利润分配方案。

公司自上市以来，十分重视对全体股东的分红回报，每年进行利润分配，上市以来累计现金分红 24,900 万元（含税）。其中，2024 年度现金分红已经实施完成，2024 年度向全体股东每 10 股派发现金红利 1.63 元（含税），派发现金红利总额为 3,260 万元（含税）。

未来，公司将根据自身经营状况和业务发展目标，充分利用分红后留存的未分配利润和自有资金，保证未来经营的稳健发展，实现业绩增长与股东回报的动态平衡，打造可持续发展的股东价值回报机制，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，推动公司“提质增效重回报”的行动。

### **（二）制定稳定股价预案，保障股东权益**

2025 年，公司密切关注资本市场情况，并通过定期交流，引导股东长期投资，合理选择减持方式，控制减持规模和节奏，降低市场影响。为提高公司质量、投资价值、投资者回报能力，公司制定了《市值管理制度》，形成系统性、规范性、科学性、常态性的市值管理行为，设定合理、科学的触发启动机制，以及启动稳定股价的相应措施，包括积极与投资者沟通、发布澄清公告、官方声明、回购公司股份等相应的股价维稳措施，以积极维护公司市场价值并增强投资者信心。

## **六、强化“关键少数”责任，推动公司规范运作**

公司始终重视“关键少数”在公司生产经营过程中的重要作用，持续强化“关键少数”的履职责任，推动公司持续规范运作，有效规避相关风险。公司全力支持董事、监事、高级管理人员参与上海证券交易所、中国上市公司协会等举办的各种线上培训活动。

报告期内，共计组织公司董监高参与培训4次，覆盖7人次，包括：独立董事能力建设培训（中上协会）、2025年第5期上市公司独立董事后续培训（上海证券交易所）、2025年第3期上市公司董事会秘书后续培训（上海证券交易所）、“高质黔行”第三期并购重组专题培训（贵州证券业协会）

## 第二部分 2026年度“提质增效重回报”行动方案

2026年公司将重点围绕，电机控制、信号调理微系统及射频微波等领域，专注于为客户提供模拟信号链全域解决方案。始终坚持以科技创新为驱动，聚焦集成电路主业，狠抓科技创新、市场拓展、精益生产、人才队伍，完善公司治理，加强投资者关系管理和注重投资者回报，奋力实现“十五五”发展开好局、起好步。

### 一、聚焦主业攻坚，全域布局协同发展

#### （一）持续提升科技创新能力，构筑技术护城河

2026年，公司将建立“用户牵引+敏捷开发”的研发机制。紧跟特种装备及新兴领域需求，持续加大研发投入，优化流程管控，缩短新品上市周期。同时深化产学研协同创新，强化抗辐照、射频微波、先进封装的技术攻关，加速成果转化与核心技术孵化，构筑高壁垒技术护城河。

#### （二）加强核心技术攻关，夯实芯片技术根基

2026年，公司将组建专项技术攻关组，联合高校院所开展核心技术深度研究，提升抗辐射芯片辐照阈值、高端驱动器响应精度等关键指标，完善信号调理电路、电机控制产品等关键品类，推动产品从“芯片到系统”的全覆盖，构建差异化竞争优势。全面推进模块国产化电机驱动系统、商业运载火箭信号调理系统、舵机控制器、谐振传感器SIP调控芯片、磁编码器等关键项目。

### **（三）工艺制造升级，测试验证完善**

2026年，争取突破高密度塑封键合基板类、高速倒装类、封装技术，建立快速响应的柔性SMT类微组装技术体系。重点建立高精度、高压测试平台、补充芯片级失效分析能力、针对微波射频类器件的回波损耗、噪声系数等参数提升应用验证验证广度，计划开展智能检测建设工作，覆盖测试、等试点工序，达到智能化检验。

### **（四）深化产学研协作，多维协同生态**

2026年，持续深化与高校院所及下游头部系统厂商的产学研合作，共建“高端芯片技术联合实验室”，推动“芯片定义系统”与“系统牵引芯片”双向融合，全面提升公司在高端模拟芯片领域的核心竞争力与产业链话语权。

### **（五）拓维市场布局，构建全域发展体系**

2026年，巩固核心增长领域：聚焦新型大批量消耗类装备赛道，依托量大面广、持续消耗的产业特点，打造公司持续增长的重要支撑。紧盯放大器等优势核心产品，精准研判未来市场规模，培育一批订单稳定、可持续的重点型号产品，筑牢长远发展的市场根基。

紧盯未来市场布局：密切跟踪装备升级换代趋势，深入研究下一代装备对模拟集成电路的需求态势，超前布局关键核心技术与重点产品。

攻坚民用市场增量：聚焦低空经济、医疗电子、商业航天等国家战略新兴领域，开展市场需求精准调研，推出低成本、高适配性的民用产品方案；建立民品市场快速响应机制，缩短产品研发、制造、测试到投入市场的周期，努力打造公司新的利润增长点，推动业务协同发展。

探索国际市场拓界：制定目标市场专项开拓计划，梳理适配国际市场的产品体系并完成相关认证；依托集团公司渠道，搭建国际化市场运营体系，负责市场对接、商务洽谈和客户服务，迈出公司国际化发展的实质性步伐，逐步构建多元化市场格局，全面提升市场抗风险能力。

## **二、深化改革创新驱动 全面激发内生发展动力**

### **（一）抓实生产管理，提增运营效能**

2026年，公司将梳理从订单接收到生产交付各环节流程，解决流程冗余与各计划间断点问题，提升流程运转效率，将原有流程运行时间进行缩短。提升交付能力：结合精细化管理要求，优化生产排产方案、提升产线运行效能，推动销售、生产、采购、物流各环节高效协同，将订单按期交付率提高，提升客户满意度。

## **（二）深化改革创新，激发内生动力**

深化三项制度改革：全面落实“劳动、用工、分配”制度改革，建立以价值贡献为导向的绩效评价体系，真正实现人员能上能下、收入能增能减。

财务精准管理：深化全面预算管理，严控预算刚性，推动资源配置贴合战略目标。开展降本增效行动，搭建标准成本体系，严控核心成本支出；强化应收账款、存货周转管控，提升资产运营效率。

实施人才强企战略：招聘芯片领域领军人才，联动高校吸纳双一流优质人才。构建“校企联合+导师带徒”培养体系，优化薪酬激励与晋升通道、落实人才补贴，厚植育人留才环境，实现人才引育留用闭环。

## **三、持续完善公司治理，护航稳健发展**

### **（一）强化规范运作**

2026年，公司将紧密跟踪法律法规与监管政策的最新动态及调整要求，持续健全内部管理制度体系与全流程合规管理体系，完善权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理结构，全面提升公司规范运作水平、治理效能与经营风险全周期防控能力。

公司将严格规范股东会、董事会的运作机制，确保会议的召集、召开、表决全流程合法合规，刚性执行股东会、董事会各项生效决议；持续强化董事会下战略、审计、薪酬与考核、提名四大专门委员会建设，优化各专门委员会议事规则与履职流程，充分释放其专业支撑与决策赋能作用；持续完善独立董事全链条履职保障体系，全面保障独立董事的知情权、参与权、监督权与独立发表意见权，充分发挥独立董事在重大经营决策事前把关、专业咨询、制衡监督等方面的核心作用，常态化运行独立董事专门会议机制，持续提升董事会决策的科学性、审慎性与合规性。

## **（二）强化风险管控**

2026年，公司持续深化“七位一体”风险管理体系建设，结合经营发展，加强对新业务领域的风险识别及防控，化解各类风险隐患，推动全年风险防控目标的达成，确保公司生产经营全流程始终处于可控、在控状态。

## **（三）创造长期可持续价值**

2026年，公司将持续关注中国国内外监管趋势和利益相关方期望，推动ESG理念与公司战略、研发投入和运营管理的进一步融合，不断提升公司在可持续发展方面的前瞻性和执行力，努力在国际及国内主流ESG评级体系中获得进一步的认可，为股东、员工、客户及社会创造长期、稳定和可持续的价值。

## **四、强化投资者沟通，增进市场价值认同**

2026年，公司将严格遵循法律法规和监管要求，执行公司信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，构建与投资者良好互动的生态，积极应对市场变化、响应投资者诉求，为投资者创造长期价值。公司将继续保持与投资者的线上交流活动，每年将通过“上证路演中心”等平台举办多次投资者线上交流会，并组织投资者调研接待不少于20次。

公司将通过引导中小投资者积极参加公司股东会等方式，畅通投资者参与公司治理的渠道，为各类投资者主体参与重大事项决策创造便利，增强投资者的话语权和获得感。最后，公司将持续完善投资者意见征询和反馈机制，提高信息披露的透明度，深入了解投资者的实际诉求，并通过各种渠道进行针对性回应，在合规的基础上，让投资者全面及时地了解公司的经营状况、发展战略等情况。持续加强与投资者的交流与沟通，增进投资者对公司的信任与支持，努力做到上证E动平台回复率100%，投资者关系热线接听回复率100%，投资者关系邮箱回复率100%。

## **五、注重投资者回报机制，共享公司发展红利**

公司坚持稳健、可持续的分红策略，兼顾现金分红的连续性和稳定性，根据公司的盈利情况、现金流状况以及未来发展规划等因素，制定合理的利润分配方案。2026年4月29日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《2025年度

利润分配预案》。公司以总股本 200,000,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.70 元（含税），合计拟派发现金红利 34,000,000.00 元（含税），占公司 2025 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 20.00%。公司 2025 年度利润分配预案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议通过。

2026 年，公司将根据自身经营状况和业务发展目标，充分利用分红后留存的未分配利润和自有资金，保证未来经营的稳健发展，实现业绩增长与股东回报的动态平衡，打造可持续发展的股东价值回报机制。为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，推动公司“提质增效重回报”的行动。

## **六、压实关键少数责任，健全利益共担机制**

2026 年，公司将根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》结合《公司章程》制度并发布《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，建立健全符合现代企业管理制度要求的激励和约束机制，充分调动其工作的积极性和创造性，发挥其管理、监督职能，提高企业经营管理水平。

公司将结合年度财务状况、经营业绩等目标的综合完成情况对公司董事、高级管理人员进行绩效考评，将董事、高级管理人员薪酬与公司经营业绩相挂钩。董事会薪酬与考核委员会负责研究并监督对公司高级管理人员的激励、考核和方案实施。将公司高级管理人员业绩考核及薪酬与公司长远发展和股东利益相结合。进一步强化管理层与股东的利益共担共享机制，强化“关键少数”对于公司经营发展的责任意识 and 责任担当，推动公司的长期稳定发展。

积极组织董事、高级管理人员参加中国证监会、上海证券交易所组织的专项培训，确保及时了解最新法律法规，提升履职能力。同时，公司将加强与董事、高管的互动沟通，及时向其反馈资本市场监管部门的相关案例，多维度提升公司治理能力，切实推动公司高质量发展，维护全体股东的利益。

## **七、其他事宜**

公司持续评估具体举措，在 2025 年度方案基础上进一步优化制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。未来，公司将专注主业，提升公司核心竞争力、盈

利能力和风险管理能力，通过良好的经营管理、规范的公司治理积极回报广大投资者，切实履行上市公司责任和义务，促进资本市场平稳健康发展。本次行动方案系基于目前公司的实际情况制定，不构成公司对投资者的实质性承诺，未来可能受宏观政策调整、行业市场环境等因素变化的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。

贵州振华风光半导体股份有限公司董事会

2026年4月29日